

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年10月24日(24.10.2024)

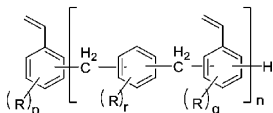
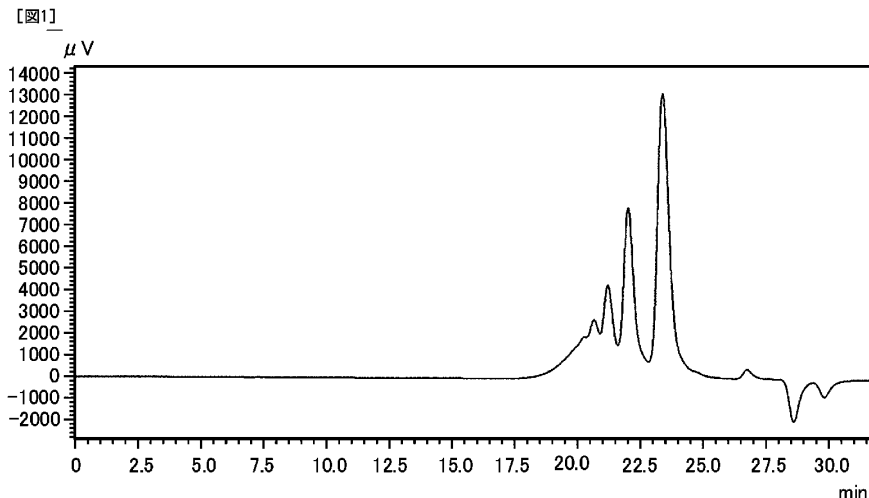


(10) 国際公開番号
WO 2024/219272 A1

- (51) 国際特許分類:
C08F 212/00 (2006.01) *C08G 61/10* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/014302
- (22) 国際出願日: 2024年4月8日(08.04.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-069238 2023年4月20日(20.04.2023) JP
- (71) 出願人: 日本化薬株式会社(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 遠島 隆行 (TOHJIMA Takayuki); 〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 橋本 昌典 (HASHIMOTO Masanori); 〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人信栄事務所(SHIN-EI, P.C.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目7番13号 虎ノ門イーストビルディング8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) Title: CURABLE RESIN COMPOSITION AND CURED PRODUCT OF SAME

(54) 発明の名称: 硬化性樹脂組成物およびその硬化物



(1)

(57) Abstract: The present invention provides: a curable resin composition having a low dielectric loss tangent; and a cured product of the same. This curable resin composition contains: a compound represented by formula (1); and a compound having one ethylenically unsaturated double bond in the molecule. In formula (1), each instance of R existing in a quantity of more than one independently represents a hydrogen atom, a hydrocarbon group having 1-10 carbon atoms, or a halogenated alkyl group having 1-10 carbon atoms. p and r each represent an integer of 0-4, q represents an integer

[続葉有]

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

of 0-3, and n represents the average of number of repeats and satisfies $1 \leq n \leq 20$.

(57) 要約: 本発明は、低誘電正接を示す硬化性樹脂組成物及びその硬化物を提供する。下記式(1)で表される化合物と、分子内にエチレン性不飽和二重結合を1つ有する化合物とを含有する硬化性樹脂組成物。式(1)中、複数存在するRはそれぞれ独立して、水素原子、炭素数1~10の炭化水素基、または炭素数1~10のハロゲン化アルキル基を表す。p、rは0~4の整数、qは0~3の整数を表し、nは繰り返し数の平均値であり、 $1 \leq n \leq 20$ である。